

第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載 PCI-E(x16)×4、PCI-E(x8)×2装備



画像処理・マシンビジョン向け ラックマウント型PC
IPC-C621DAI-R4

- 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載
- デュアルCPU搭載時、最大40コア(80スレッド)搭載
※Gold 6230プロセッサ
- インテル® C621チップセット装備
- 最大4TBメモリー(DDR4)搭載可能
- 4基のPCI-E(x16)シグナルが使用可能
- 2基のPCI-E(x8)シグナルが使用可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



✓ 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載

IPC-C621DAI-R4には、14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ」を2CPU搭載しています。上位モデルのXeon® Gold 6230を選択すると最大40コア80スレッド(2CPU搭載時)になります。

✓ 最大4基のPCI-E(x16)シグナル、最大2基のPCI-E (x8)シグナルが使用可能

最大4基のPCI Express x16スロット(x16シグナル)と2基のPCI Express x8スロット(x8シグナルGen 3.0)を装備。すべてのPCI Expressは、CPU側とダイレクトに接続しています。拡張ボードはPCH側を経由せず直接CPUと高速通信ができます。ハイエンドGPUやフレームグラバードなどを搭載しても処理速度の低下を招くことはありません。

■製品仕様

モデル	IPC-C621DAI-R4	
プロセッサ	種類	第2世代 インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20 コア 40 スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12 コア 24 スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10 コア 20 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8 コア 16 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8 コア 16 スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時 4.00GHz、TDP130W) Gold 6128 (6 コア 12 スレッド、3.40GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP115W) Gold 5222 (4 コア 8 スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP105W)
	搭載数	2
チップセット	インテル® C621 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz
	容量	標準 32GB (8GB × 4) ※最大 4TB
	スロット数	16
ストレージ	5 インチベイ	3
	3.5 インチベイ	外部 1、内部 4(空き 2) ※標準：システム用 480GB SSD × 1 (2.5 インチ変換マウントを使用。最大 2 台まで搭載可能) ※標準：データ用 1TB HDD × 1
	スリムドライブベイ	1
	SATA コネクタ数	10 (空き 8) (SATA 3.0) ※標準：SSDx1、HDDx1 で使用
グラフィックス	Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 1 (USB3.1、TypeC)、1 (USB3.1、TypeA)、4 (USB3.0)
	LAN	2 (GbE)
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
拡張スロット	SLOT7 : None SLOT6 : PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU2 側) ※メモリスロットと位置が重なるため、カード長に制限あり SLOT5 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU2 側) SLOT4 : PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU2 側) SLOT3 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU2 側) SLOT2 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU1 側) SLOT1 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU1 側)	
外形寸法	4U ラックマウント W430mm × D546mm × H176mm(突起物を除く)	
重量	TBC	
電源	V-Serialize V1300 Platinum	
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10℃ ~ 35℃
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃ ~ 55℃
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)

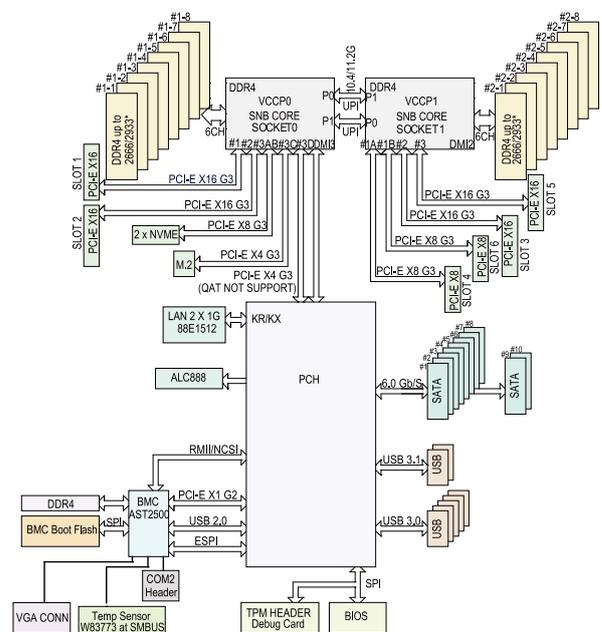
■拡張スロット



■I/Oポート



■ブロック図



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間: 9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL: 03-5446-5535 mail: cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト: <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2020年1月現在の内容です。

Z490を採用し、第10世代Core™ プロセッサ搭載 ハイエンドGPU×2枚を搭載可能



画像処理・マシンビジョン向け ラックマウント型PC
IPC-C490PGO-R4

- 第10世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® Z490チップセット装備
- 最大128GBメモリー (DDR4)搭載可能
- オプションでGeForce RTX™ 3090を最大2基搭載可能
- 20Gbpsの転送速度を実現するUSB 3.2 Gen2x2を装備
- 10GBASE-T LAN搭載



✓ ハイエンド向けインテル® Z490チップセットを採用

インテル® Z490チップセットは、第10世代インテル® Core™ プロセッサに対応し、400シリーズチップセットで唯一オーバークロックに対応。高速な画像処理が求められる外観検査装置などにおける処理性能の向上に寄与します。

✓ 10GBASE-T LAN搭載

1GB LANの10倍の転送速度を実現する10GB LANを装備。データ量が大きく高解像度画像などを扱うマシンビジョン・画像処理分野において、高速伝送を実現します。

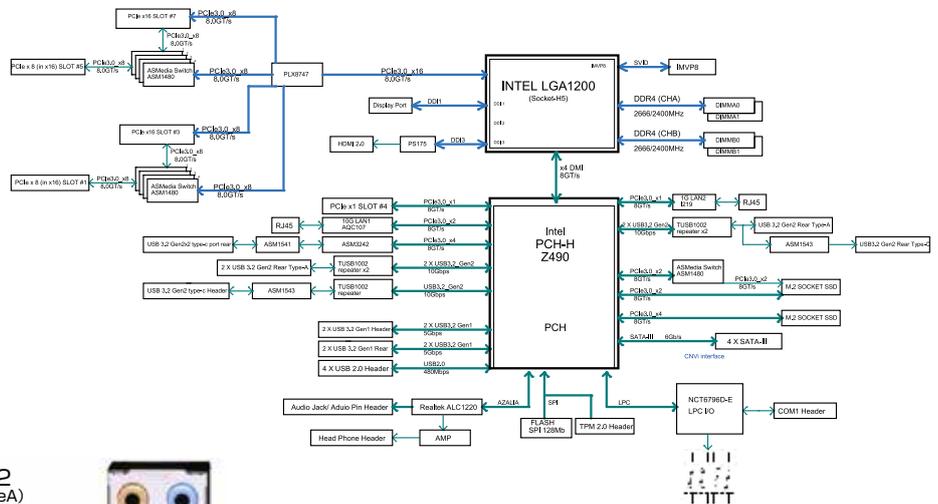
製品仕様

モデル	IPC-C490PGO-R4	
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサ ※ TDP 最大 140W までのインテル® Core™i9 / Core™i7 / Core™i5 / Core™i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサをサポート
	搭載数	1
チップセット	インテル® Z490 チップセット	
メモリー	規格	DDR4-2933
	容量	標準 16GB (8GB × 2) ※最大 128GB
	スロット数	4
ストレージ	5 インチベイ	3
	3.5 インチベイ	内部 1 (空き 0) ※標準: 240GB SSD × 1 (3.5 インチ → 5 インチ変換マウントを使用)
	SATA コネクタ数	4 (空き 3) (SATA 3.0) ※標準: SSD で 1 本使用
GPU	※オプション: GeForce RTX™ 3090 を最大 2 基搭載可能。GPU 搭載数により電源容量の変更が必要。	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	HDMI	1
	DisplayPort	1
	USB	前面 2 (USB2.0, TypeA) / 背面 2 (USB3.2 Gen2, TypeA)、2 (USB3.2 Gen1, TypeA)、1 (USB3.2 Gen2, TypeC)、1 (USB3.2 Gen2x2, TypeC)
	LAN	1 (10GbE)、1 (1GbE)
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
	CMOS クリアボタン	1
拡張スロット	Slot7: PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16/x8 シグナル、CPU 側) Slot6: Non Slot5: PCI-Express x16 (Gen 3.0、NA/x8、CPU 側) Slot4: PCI-Express x1 (Gen 3.0、PCH 側) Slot3: PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16/x8、CPU 側) Slot2: Non Slot1: PCI-Express x16 (Gen 3.0、NA/x8、CPU 側)	
外形寸法	4U ラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)	
重量	標準: 約 19kg RTX3090x2 搭載時: 約 22kg	
電源	標準: ニプロン電源 400W (連続最大容量) / 570W (ピーク容量) ※ GPU 搭載数により電源容量は変更となります。	
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10°C ~ 35°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10°C ~ 55°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)

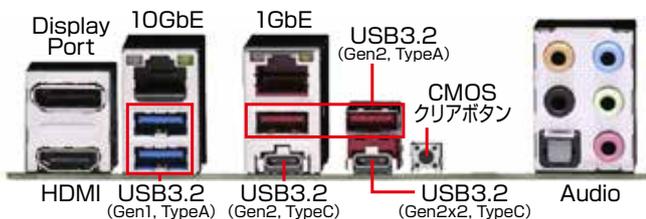
拡張スロット



ブロック図



I/Oポート



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間: 9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL: 03-5446-5535 mail: cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト: <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2020年11月現在の内容です。

小型な筐体の第10世代Core™ プロセッサと Q470Eチップセットを搭載する産業用コンピュータ



画像処理・マシンビジョン向け タイニー型PC
IPC-C470SCQ-TY



- 第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® Q470Eチップセット装備
- USB3.2(Gen2)を計4基装備
- 組み込みに適したコンパクトサイズ
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成

☑ 長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセットと 第10世代インテル® Core™プロセッサを搭載

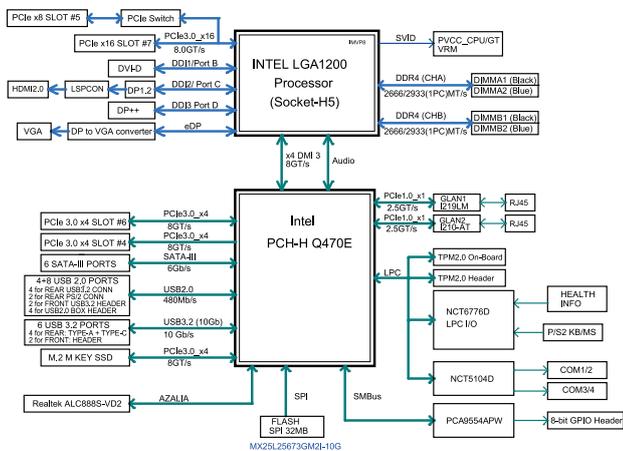
生産品質と効率向上を加速させ、長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセットと第10世代インテル® Core™プロセッサを搭載する産業用コンピュータ。

第10世代インテル® Core™プロセッサでは、コア数が最大10コア/20スレッドまでとなり、目的に応じてマルチタスク処理の向上に適したパフォーマンスをご選択いただくことが可能です。

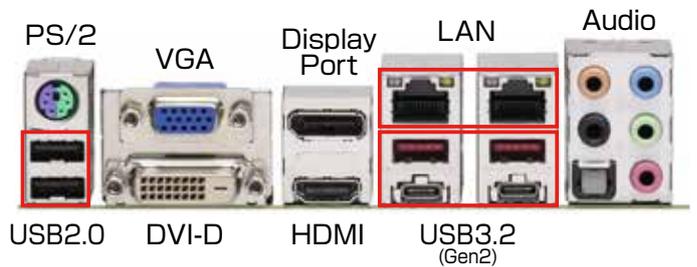
■製品仕様

モデル	IPC-C470SCQ-TY	
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー ※TDP最大65Wまでのインテル® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサをサポート
	搭載数	1
チップセット	インテル® Q470Eチップセット	
メモリー	規格	DDR4-2933 nECC
	容量	標準16GB (8GB×2) ※最大128GB (32GB×4)
	スロット数	4
ストレージ	3.5インチベイ	1 ※標準:3.5インチストレージで使用
	3.5インチシャドーベイ	1 ※2.5インチストレージ×2搭載可能
ODD	DVDスーパーマルチドライブ	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	PS/2	1 (KB/Mouse)
	HDMI	1
	DisplayPort	1
	DVI-D	1
	VGA	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA)
	LAN	2 (GbE)
	Audio	6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
拡張スロット	Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0, x16/x8シグナル, CPU側) Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, 4シグナル, PCH側) Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 3.0, Non/x8シグナル, CPU側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, 4シグナル, PCH側)	
外形寸法	タワー W136mm × D386mm × H356mm (突起物等を除く)	
重量	約9kg	
電源	ニプロン電源 310W (連続最大容量)/400W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)

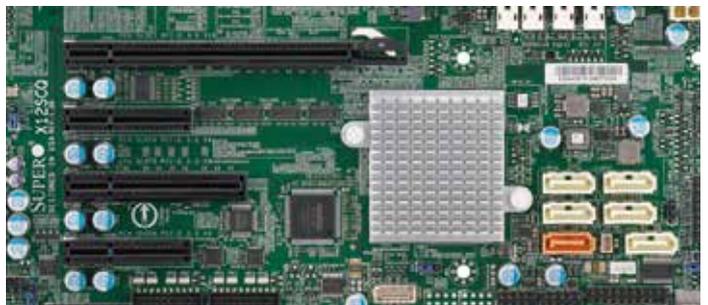
■ブロック図



■I/Oポート



■拡張スロット



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年4月現在の内容です。